

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號
聯絡人：朱家昱
聯絡電話：02-29393091#66890

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國 113年7月17日

發文字號：政研發字第1130024118號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：國科會函及申請須知各1份

主旨：國科會與德國聯邦教育及研究部（BMBF）共同徵求 2025-2028 年「臺德半導體晶片設計學術合作研究計畫」，自即日起至受理申請，校內截止收件時間為113年 9月13日（星期五）下午5時止，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依國家科學及技術委員會113年7月15日科會科字第 1130048920號函辦理。
- 二、依據國科會及德國BMBF於2023年3月21日簽署臺德科學及技術合作協議（STA），共同徵求旨揭計畫（第二期），申請方式詳如附件公告申請須知及國科會網頁「計畫徵求專區」。
- 三、本項徵件計畫期程以3年為原則，自2025年5月1日開始執行，臺德雙方計畫主持人共同研議計畫內容後，須分別向國科會及德國BMBF於申請截止期限內提出申請書，始得成案。
- 四、為使更多半導體領域之學者專家參與本次共同徵件，國科會與德方BMBF將於2024年8月7日（週三）下午，共同舉辦「臺德雙邊研究人員線上交流會議」，鏈結臺德半導體領域學者互動交流，歡迎有興趣學者線上參與，報

- 名及參與方式另於國科會網站公告。
- 五、有意申請者請於旨揭截止日期前完成線上申請作業，並請所屬單位於次日中午前將申請名冊（經單位主管核章）送達研發處，俾利備函彙送國科會提出申請。
 - 六、檢送國科會來函及申請須知各1份。
 - 七、本計畫相關申請疑義，請洽國科會科國處李蕙瑩研究員，電話：(02)2737-7150；有關係統操作問題，請洽國科會資訊系統服務專線，電話：0800-212-058及(02)2737-7590~7592。

正本：本校各院、系、所、研究中心(電子布告欄)

副本：研究發展處

校長 李蔡彥